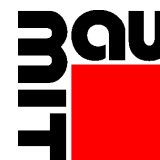


Zaprawa klejowa Baumacol Basic (Baumit Baumacol Basic)



baumit.com

Produkt	Wodo- i mrozoodporna, hydraulicznie wiążąca, cienkowarstwowa zaprawa klejowa na bazie szarego cementu. Dopuszczona do kontaktu ze środkami spożywczymi. Sklasyfikowana wg normy PN-EN 12004:2002 - C1.
Przeznaczenie	Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, mozaiki, płyt z włókna szklanego, lekkich płyt budowlanych oraz twardych płyt styropianowych. Do stosowania na podłożach nieodkształcalnych.
Dane techniczne	(w warunkach normatywnych – w temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%) Zużycie: ok. 3 kg/m ² , zależnie od rodzaju płytek paca zębata: 3 6 10 mm zużycie około: 1,5 2,5 3,5 kg/m ² Zapotrzebowanie wody: ok. 6 - 7 l/worek 25 kg; Czas leżakowania: ok. 15 min. Czas użycia: do 4 godz. Czas otwarty: min. 20 minut Czas korygowania: do 5 minut Grubość warstwy: max. 4 mm
Forma dostawy	Worek - 25 kg 48 worków/paletę = 1200 kg
Przechowywanie	W suchym miejscu, na paletach - 12 miesięcy.
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Podłoże	Musi być twarde, zwarte, stabilne, niezmrożone, odpylone i odtłuszczone oraz wolne od oleju. Stosować na: beton, jastrych, gazobeton, klinkier, gotowe tynki cementowe i gipsowe, kartonowe płyty gipsowe, gipsowe ściennie płyty budowlane, jastrychy anhydrytowe; w obrębie pomieszczeń mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej Nie stosować na: drewno, metal, tworzywa sztuczne, podłoża na bazie cementu przed zakończeniem procesów wiązania; w obrębie tarasów, elewacji, basenów kąpielowych i ogrzewania podłogowego. Przygotowanie podłoża: oczyścić z pyłu i kurzu, zagruntować odpowiednim preparatem: - podłoża chłonne - Baumit Grund - podłoża o zmniejszonej nasiąkliwości - Baumit Super Grund
Obróbka	Zalecane narzędzia: Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca zębata, kielnia, gąbka paca 3 x 3 mm - klejenie mozaiki paca 6 x 6 mm - klejenie płytek o spodzie gładkim paca 10 x 10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym Przygotowanie produktu: Wsypać zawartość worka do odpowiedniej ilości czystej wody i mieszać przez ok. 3 min. czystym, wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Po ok. 15 min. ponownie, krótko przemieszać zaprawę. Proporcje: ok. 6,0 l wody na worek 25 kg

Stosowanie:

Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie na podłoże (pacę utrzymywać podczas rozprowadzania materiału pod kątem 45 stopni do podłoża). Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.

Zalecane pokrycie spodu płytki klejem (wypełnienie przestrzeni podpłytkowej):

- wewnątrz budynków > 65%
- na zewnątrz budynków oraz przy ogrzewaniu podłogowym > 90%

Zapewnienie pełnego kontaktu płytki z klejem można otrzymać poprzez układanie płytek metodą kombinowaną (BUTTERING – FLOATING), polegającą na nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i na spód płytki.

Wykończenie:

Przez ok. 48 godzin chronić klejoną powierzchnię przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi (nie chodzić i nie obciążać ułożonych płytek).

BHP

Wszelkie informacje dotyczące specyficznych właściwości produktu, jego składu, sposobu posługiwania się oraz czyszczenia i usuwania odpadów znajdują się w karcie bezpieczeństwa.

Uwagi

Przestrzegać norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczących podłoża i okładzin.

Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C, w deszczu, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub przeciągach. Chronić do czasu pełnego utwardzenia.

Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają przewidziany czas schnięcia, wysokie temperatury skracają czas wiązania i utwardzania!

Nie dodawać żadnych innych materiałów!

Nie moczyć ani podłoża ani płytek.

Bezwzględnie przestrzegać podanego czasu otwartego - schnięcia naniesionej na podłoże zaprawy klejowej.

Po przekroczeniu tego czasu zaprawę należy usunąć.